附件6

**2025年“中国芯”优秀产品征集活动**

**“整车芯应用”卓越产品申报表**

**“整车芯应用”产品定义**

近年来对我国汽车工业有卓越贡献的汽车芯片产品。关键性能参数具有市场竞争力，具有良好的可靠性和稳定性，技术路线明确清晰，在整车关键域控制器上已得到广泛应用，在行业内已形成较大影响力，并得到车企认可的车规级芯片产品。（与其他项目不可重复申报）

**申报产品信息（以下信息均为必填项）**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **项目负责人** |  | **联系电话** |  |
| **联系人** |  | **联系电话** |  |
| **通信地址** |  | **电子邮箱** |  |
| **净利润****（大致的量级）** |  | **近三年企业研发投入占营业收入的比重** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **申报产品名称及****型号/推出时间** | 名称：型号：推出时间： |
| **参选芯片的知识****产权归属** | □ 属于申请单位* 属于母公司
* 其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（请注明）
 |
| **产品应用场景分类** | □底盘 □动力 □智驾 □座舱 □车身（芯片如应用在功能安全领域请提供ISO26262证书） |
| **芯片是否通过AEC-Q测试** | □是 □否 |
| **芯片概述** |  |
| **车企评价** | **注：请提交佐证材料，**1. **芯片在Tier1应用/验证情况，企业名称、零部件产品名称、供货数量、证明材料**
2. **芯片在整车应用/验证情况，如企业名称、车型名称、供货数量、证明材料。**
 |
| **封装形式** | 封装厂 |  | 封装/生产工艺 |  |
| **生产工艺** | 代工厂 |  | 生产工艺 |  |
| **主要性能和指标** | 注：请提交产品手册等资料 |
| **本产品的创新性及所获得的知识产权形式** | **已受理专利项数** |  |
| **已获取专利项数** |  |
| 注：如有专利，请注明专利号和专利权人并附证明材料 |
| **本产品的应用市场及销售情况** |  | **销售总额****（单位：万元）** | **销售量****（单位：万颗）** |
| **自产品推出之时起至今** |  |  |
| **2024年全年** |  |  |
| **2025年上半年** |  |  |
| **2025年全年预计** |  |  |
| **市场份额** | （注：根据市场总量实际估测） |
| **对标国外相关芯片产品的情况** | （注：请列出参选产品与国外同类产品在技术参数、国内外市场占有率方面的具体情况对比，最好能体现国外相关产品的具体型号） |
| **法律声明：** **申请单位须保证填写内容的真实性及其参加活动产品的合法性，提供相应的证明材料，并承担由内容的真实性及其参加活动产品的合法性的责任。该活动主办方有权追溯取消该申请单位或该产品的一切参与活动的权利，并保留追求其法律责任的权利。**法人/授权代表签名：企业（盖章） 日期： |

**注：本表填写内容仅用于专家评选审阅，不对外公开。**